

# 2023 台灣熱管理協會年會暨技術成果發表會

## ◆活動宗旨：

2023 年全球疫情趨緩，淨零轉型浪潮蔓延至台灣中小型企業，全球面臨通膨及中美貿易戰等不確定因素；筆電及桌機市場下滑，但伺服器市場上揚。電動車市場熱度也上揚，G 世代商機則持續受到重視，電子散熱產業正積極尋找利基市場。針對這些重要趨勢及主題，2023 年協會將持續舉辦研討會進行市場、技術趨勢以及相關散熱技術的發展。

本次大會上午將邀請貴賓致詞，並進行兩場業界專家的專題報告。下午由產業界及學界進行散熱技術發表，精彩可期，邀請協會會員及對電子散熱有興趣的產學先進踴躍參加。

## ◆指導單位：經濟部技術處

## ◆主辦單位：台灣熱管理協會(TTMA)

## ◆協辦單位：工業技術研究院 材料與化工研究所、電子與光電系統研究所

## ◆舉辦時間：112 年 4 月 28 日(星期五) 09:20~15:45

## ◆舉辦地點：臺大醫院國際會議中心 402 會議室

## ◆舉辦地址：台北市中正區徐州路 2 號 電話：(02)7724-0109

## ◆敬邀對象：TTMA 會員及對熱管理有興趣之產官學研人士

## ◆議程內容：

時間	活動內容	主講人
09:00~09:20	報 到	
09:20~10:00	主席致詞及最佳論文獎頒獎 貴賓致詞	龔育諄 理事長 (美商英特爾亞太科技有限公司 Program Lead) 陳興華 組長 (工研院 材化所)
10:00~10:20	FY111 會務報告暨 FY112 工作規劃	劉君愷 秘書長
10:20~10:40	休 息	
時間	活動內容	主講人
10:40~11:20	Decision Modeling for Liquid Cooled Data Center Equipment	RT Huang, PhD (Co-Chair, Liquid Cooling SWG, The Green Grid Director, Supermicro)
11:20~12:00	New Methodology of Thermal Module Performance Inspection	馮建忠 總經理 (長聖儀器股份有限公司)
12:00~13:00	午餐及發表場地準備	

	A 場 主持人：楊建裕 教授 (國立中央大學 機械工程學系)	B 場 主持人：王啟川 講座教授 (國立陽明交通大學 機械工程學系)
時間	題目、發表人	題目、發表人
13:00~13:15	5G vRAN Thermal Mechanical Design and Validation Guidance for NEBS  田明偉 工程師 (英特爾亞太科技有限公司)	5G 低軌衛星地面站使用正統銅鋁擴散接合之散熱系統模擬與探討  李雄 教授 (國立中央大學)
13:15~13:30	Bonded Liquid Metal (BLM™) TIM to Simplify Liquid Metal TIM Applications in CPU/GPU Cooling  Dr. Himanshu Pokharna (Deep-Materials)	熱泵汙泥乾燥機之模型建構與效能探討  李博丞 先生 (國立勤益科技大學 冷凍空調與能源系)
13:30~13:45	使用兩點溫差規範標準 TTMA-VC-2020 對均溫板效能之評估  朱怡靜 經理 (高柏科技股份有限公司)	雙相介電液噴淋式冷卻系統於資料中心應用  陳浩鈞 先生 (國立陽明交通大學 機械工程學系)
13:45~14:00	應用熱熔射噴塗技術製作 Al-SiC 孔隙層與特性探討  蔡鎮守 工程師 (宏進金屬科技股份有限公司)	兩相浸沒式冷卻應用於高功率晶片之數值模擬與驗證  譚惟誠 先生 (淡江大學)
14:00~14:15	碳化矽 SiC 封裝元件瞬態熱阻訊號測試研究  潘文揚 工程師 (勢流科技股份有限公司)	STAR-CCM+應用在資料中心的沉浸式冷卻技術  邢家碩 工程師 (勢流科技股份有限公司)
14:15~14:30	應用於電池芯開發之數值模擬分析與實體量測解決方案  黃巖閔 工程師 (思渤科技股份有限公司)	金屬 3D 列印技術製作震盪式熱管  陳冠霖 先生 (淡江大學 機械系)
14:30~14:45	休 息	

	A 場 主持人：林唯耕 榮譽退休教授 (國立清華大學 工程與系統科學系)	B 場 主持人：康尚文 教授 (淡江大學 機械與機電工程學系)
時間	題目、發表人	題目、發表人
14:45~15:00	Numerical and experimental study on immersion cooling applying on HPC servers  黃鈺傑 工程師 (緯創資通股份有限公司)	不同編織方法之編織線對均熱板的性能影響  陳律宇 工程師 (前電科創股份有限公司)
15:00~15:15	1U 伺服器單相浸泡式冷卻散熱 優化設計  林佑錡 先生 (國立陽明交通大學 機械工程學系)	浸沒式高熱傳模擬計算結合 AI 實驗設計方法 分析與最優化  楊棟焜 處長 (皮托科技股份有限公司)
15:15~15:30	半導體變頻微波退火高功率模組氣冷散熱 數值模擬分析  何亞奇 先生 (國立清華大學 動力機械系)	高效率儲能系統 BESS 熱管理設計  黃紀源 經理 (虎門科技股份有限公司)
15:30~15:45	利用暫態模擬進行熱管理與分析  張盟勝 經理 (益華科技股份有限公司)	CFD Simulation of Headlamp Condensation  李嘉雄 工程師 (成基應用科技有限公司)
	散會	散會

※主辦單位得因無法控制情況，調整課別場次之課題與講師。

◆報名資訊：(含講義、午餐與精緻茶點)

1.報名方式：請逕自上網報名

<http://www.thermal.org.tw/Events/seminar-form-in.asp?BtffiysxL>

2.報名與繳費截止日：112 年 3 月 31 日(五)或額滿為止

※名額 150 人，請從速報名! 依繳費順序額滿為止。

※同時繳交兩位報名費用時，請回覆告知報名費用收據是個別或是一起開立。

※恕不受理現場報名與繳費，敬請事先完成報名手續為荷。

※報名後不克參加者，請務必於會議前三日以書面或電子郵件告知取消；未告知取消者，視同參加不予退費。

3.報名費：

TTMA團體會員：2人免費。增加名額者，每人優待為新台幣\$1,500元整

TTMA個人會員：免費(僅限本人)

一般人士：新台幣\$3,000元整

學生：新台幣\$1,000元整 (不包含在職進修生，請於3月31日前將學生證電子檔 E-mail至 TTMA@itri.org.tw，始可享有學生優惠價，以學生身份報名者，恕無法開立公司行號之收據!)

#### 4.繳費方式：

- 電匯或ATM轉帳：

收款銀行：臺灣土地銀行 工研院分行

收款帳號：156-001-00163-9 (土銀代碼：005)

收款戶名：台灣熱管理協會

※繳費後請將電匯收據電子檔或 ATM 轉帳後將轉出銀行代號 3 碼與帳號後 5 碼 E-mail 至 TTMA@itri.org.tw，謝謝!

- 即期支票：

支票抬頭：台灣熱管理協會

郵寄地址：310 新竹縣竹東鎮中興路4段195號52館703室 劉小姐收

◆報名聯絡專線：劉小姐 (03)5918269 Fax：(03)5820207 E-mail：TTMA@itri.org.tw

◆協會網址：<http://www.thermal.org.tw>

#### ◆臺大醫院國際會議中心交通及停車資訊

##### ●會議中心週邊動線圖



## 交通

### ➤➤ 搭乘公車

台大醫院站：22 / 15 / 615 / 227 / 648 / 648 綠 / 中山幹線 / 208 / 208 直達車，步行約 3 分鐘即可抵達

開南商工站(近徐州路口)：0 南 / 15 / 22 / 208 / 295 / 297 / 671，步行約 3 分鐘即可抵達

仁愛林森路口站 (林森南路口)：295 / 297 / 15 / 22 / 671，步行約 3 分鐘即可抵達

仁愛林森路口站 (仁愛路口)：245 / 261 / 37 / 249 / 270 / 263 / 621 / 651 / 630，步行約 5 分鐘即可抵達

### ➤➤ 搭乘捷運

淡水北投線(紅線)：台大醫院站 2 號出口

-> 搭乘淡水信義線(紅線)至台大醫院站 2 號出口直走常德街，穿越中山南路後往左側直走後再右轉徐州路，步行大約 6 分鐘即可抵達

板南線(藍線)：善導寺站 2 號出口

-> 搭乘板南線(藍線)至善導寺站 2 號出口，沿林森南路往南走經青島東路、濟南路，遇徐州路右轉，步行約 7-10 分鐘內即可抵達

### ➤➤ 自行開車

1. 請沿林森南路往南過徐州路至台大醫院國際會議中心停車場入口進入。
2. 請沿仁愛路一段往西過林森南路至台大醫院國際會議中心停車場入口進入。

## 會議中心停車動線圖

會議中心備有 B2~B3 停車場，共 120 個停車位，每小時 NT\$50，單日最高 NT\$400。

